

# Innovative Halbleiter-Lösungen für mehr **Energieeffizienz, Mobilität** und **Sicherheit**



Unternehmenspräsentation

01. Feb. 2011



- Markt- und Geschäftsentwicklung im ersten Quartal GJ 2011
- Zielmärkte
- Divisionen, Produkte und Technologien
- Allgemeine Informationen zum Unternehmen

- Markt- und Geschäftsentwicklung im ersten Quartal GJ 2011

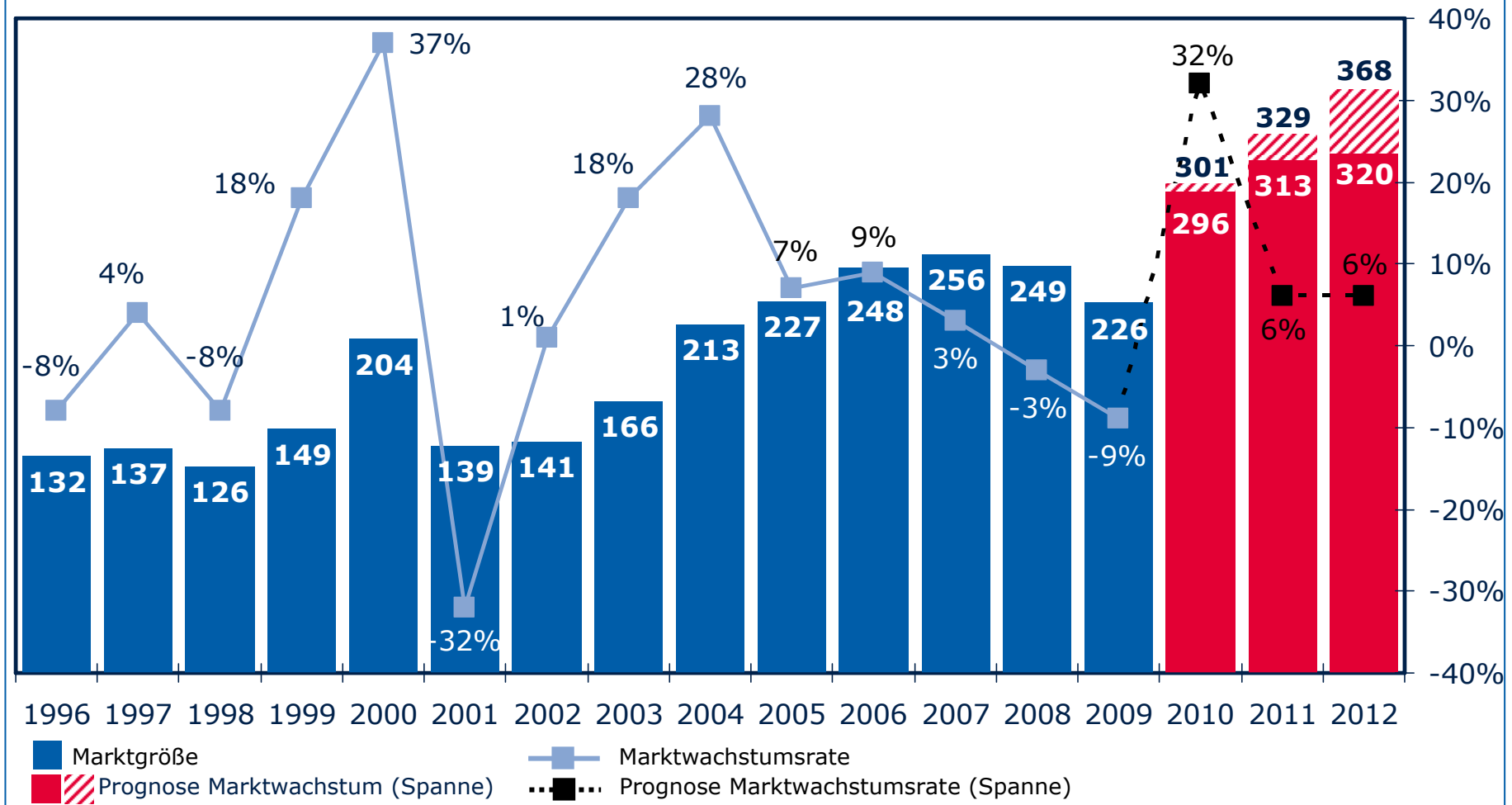
- Zielmärkte

- Divisionen, Produkte und Technologien

- Allgemeine Informationen zum Unternehmen

# Entwicklung des globalen Halbleitermarkts

## Marktgröße in Milliarden US-Dollar und Marktwachstumsrate



# Infineon ist die Nummer 1 in allen Zielmärkten



## Auto- motive

# 1

Marktanteil

9%

Kalenderjahr 2009  
Quelle: Strategy Analytics,  
Mai 2010

## Leistungs- halbleiter

# 1

Marktanteil

11%

Kalenderjahr 2009  
Quelle: IMS Research,  
Juli 2010

## Chipkarten

# 1

Marktanteil

27%

Kalenderjahr 2009  
Quelle: Frost & Sullivan,  
Oktober 2010

## Das Unternehmen

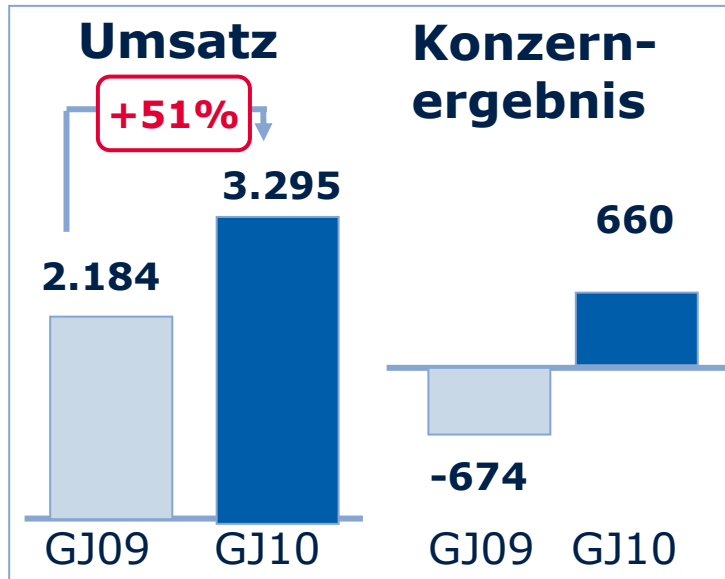
- Infineon adressiert mit seinen Halbleiter- und Systemlösungen die zentralen Bedürfnisse der modernen Gesellschaft: **Energieeffizienz, Mobilität und Sicherheit**
- Umsatz im Geschäftsjahr 2010\*: 3,295 Mrd. EUR
- 27.315\*\* Mitarbeiter weltweit (Stand: Dezember 2010)
- Über 20 F&E-Standorte
- Deutschlands größtes Halbleiterunternehmen

\*Hinweis: Angaben gemäß IFRS einschließlich der Wireline- und Wireless-Sparten als nicht fortgeführte Aktivitäten;  
Stand: 30. September 2010

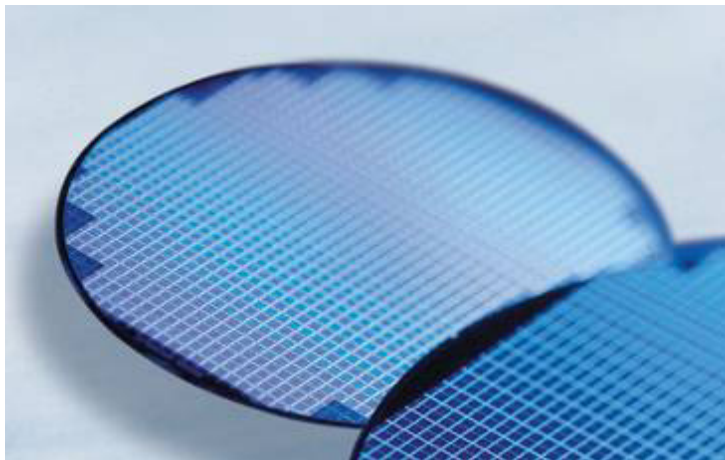
\*\*Hinweis: Beinhaltet die Wireless-Sparte als nicht fortgeführte Aktivität; Stand: 31. Dezember 2010

# Infineon-Konzern

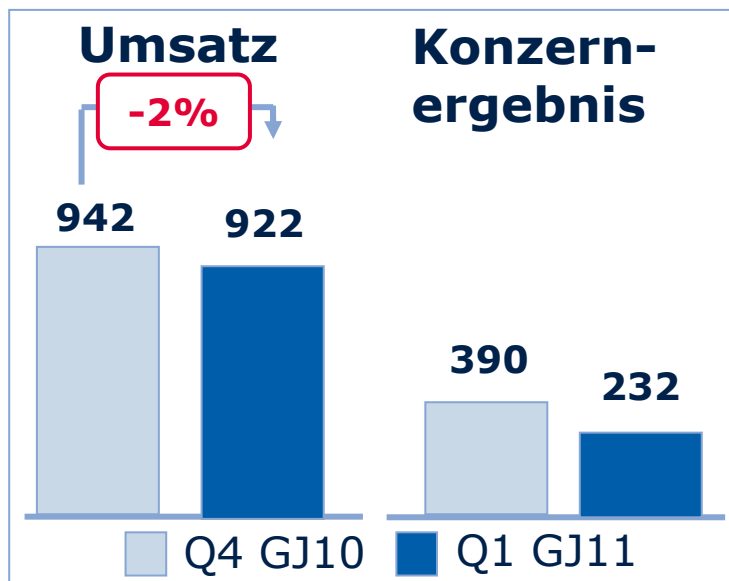
## Ergebnisse GJ 2009 und GJ 2010



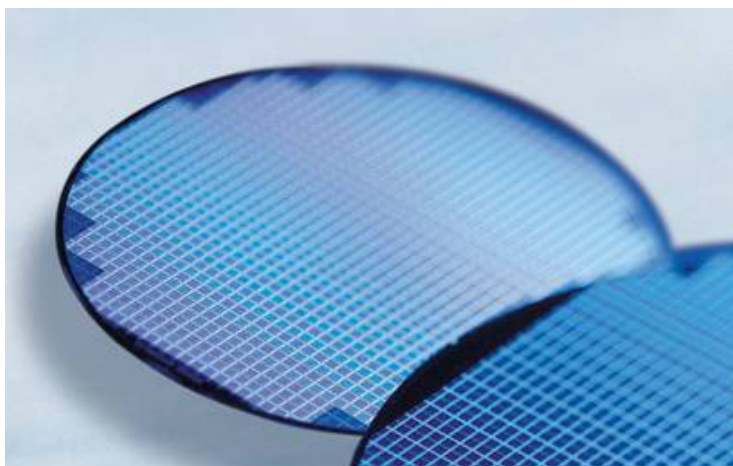
[Mio. Euro]	2009	2010
Umsatz	2.184	3.295
Segmentergebnis	-140	475
Segmenterg. Marge	-6,4%	14,4%
Konzernergebnis	-674	660



Free-Cash-Flow	274	573
Investitionen (Sachanl.)	96	292
Netto-Debt/Cash	657	1.331
Marktkapitalisierung	~4.200	~5.522



[Mio. Euro]	Q4/10	Q1/11
Umsatz	942	922
Segmentergebnis	171	177
Segmenterg. Marge	18%	19%
Konzernergebnis	390	232

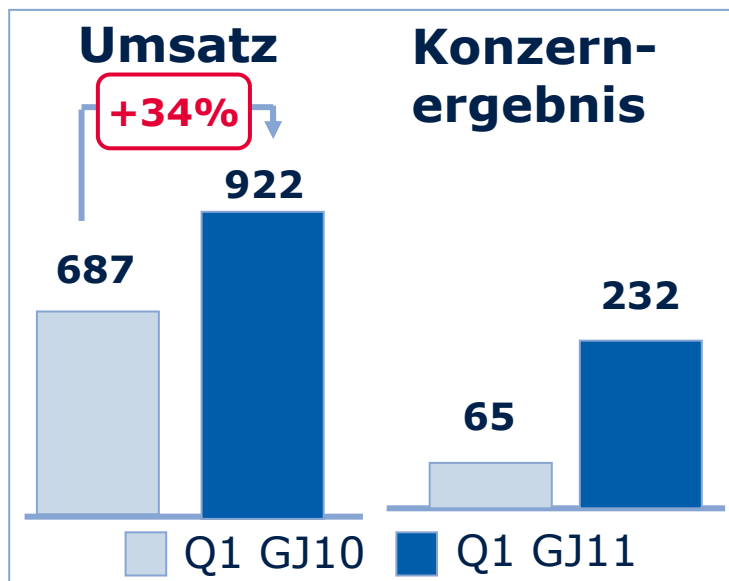


Free-Cash-Flow	236	4
Brutto-Cash	1.727	1.669
Netto-Cash	1.331	1.293

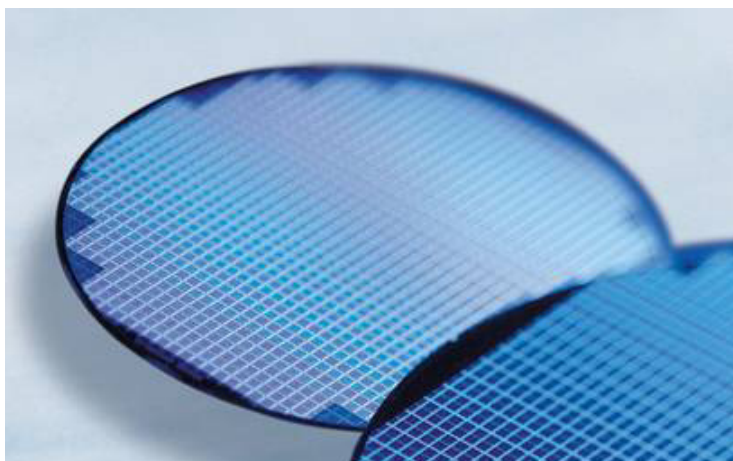


Hinweis: Angaben gemäß IFRS einschließlich Wireline und Wireless als nicht fortgeführte Aktivitäten; Stand: 30. September 2010





[Mio. Euro]	Q1 10	Q1 11
Umsatz	687	922
Segmentergebnis	70	171
Segmenterg. Marge	10%	19%
Konzernergebnis	65	232



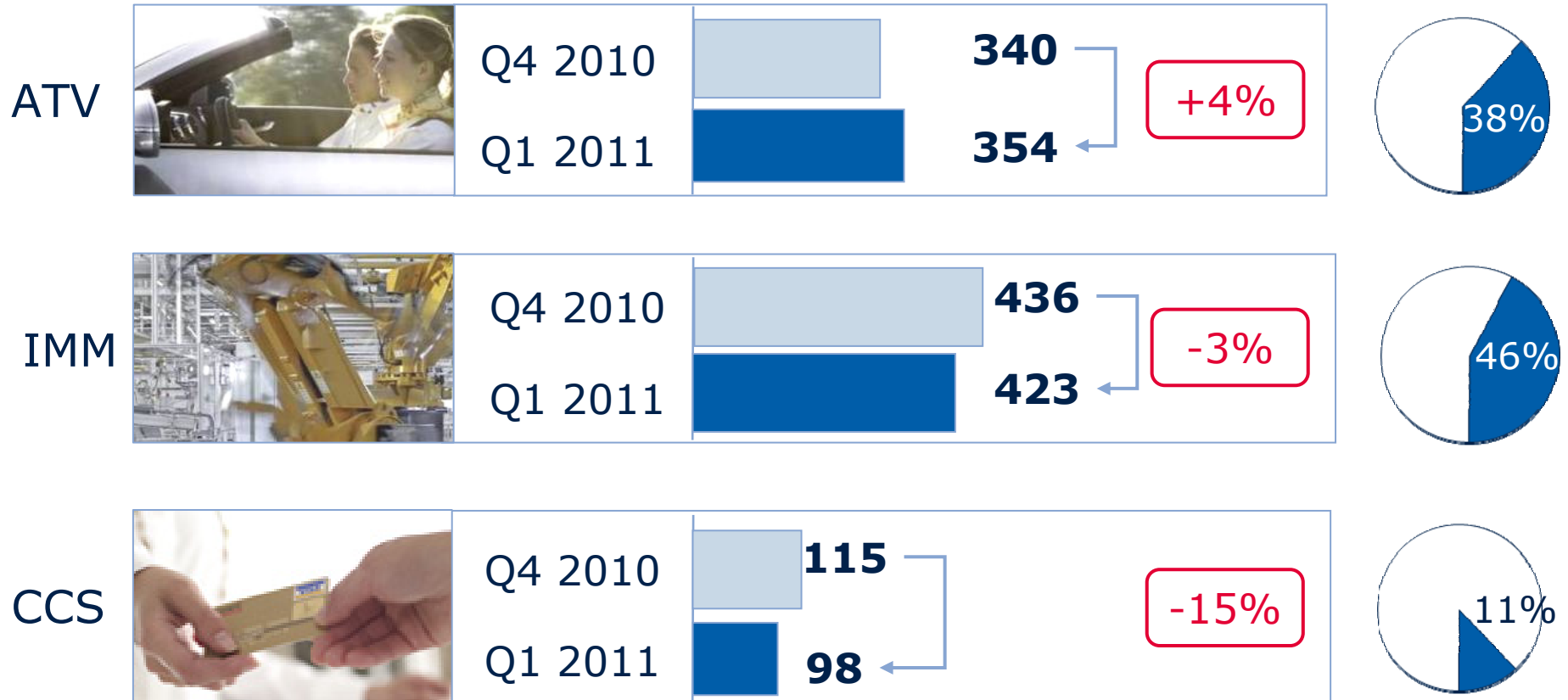
Free-Cash-Flow	-21	4
Brutto-Cash	1,678	1,669
Netto-Cash	874	1,293

Hinweis: Angaben gemäß IFRS einschließlich Wireline und Wireless als nicht fortgeführte Aktivitäten; Stand: 30. September 2010

# Umsatzerlöse nach Segmenten Q4 GJ 2010 und Q1 GJ 2011


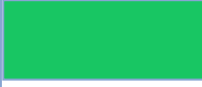

Umsatz\* in Mio. Euro

Anteil am Gesamtumsatz



\* Im Gesamtumsatz enthalten sind Sonstige Geschäftsbereiche (Q4 GJ10: 56 Mio. €, Q1 GJ11: 41 Mio. €) sowie Konzernfunktionen und Eliminierungen (Q4 GJ10: -5 Mio. €, Q1 GJ11: 6 Mio. €).

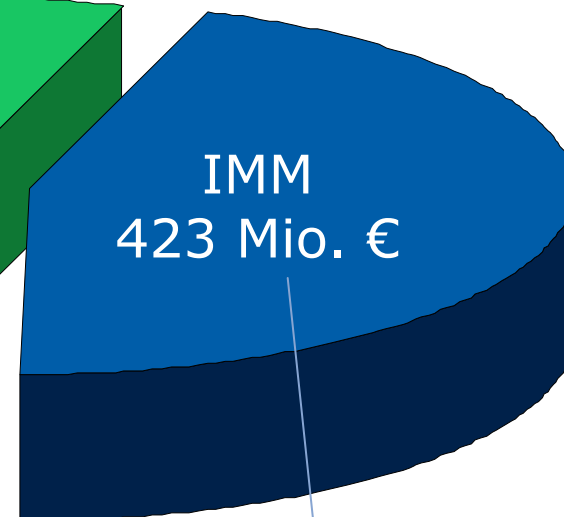
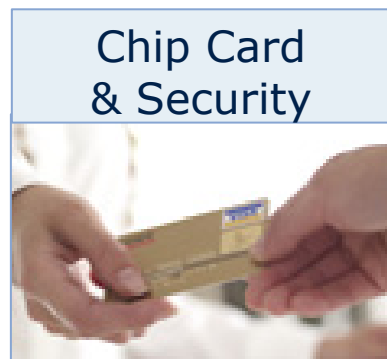
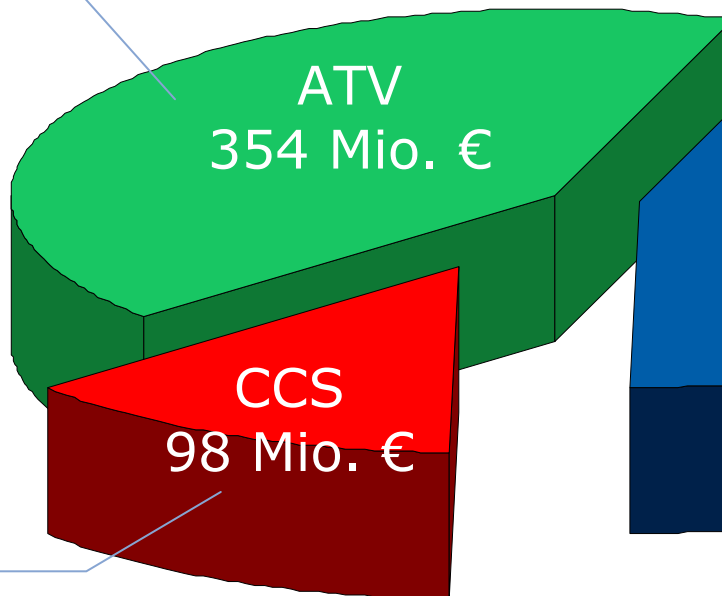
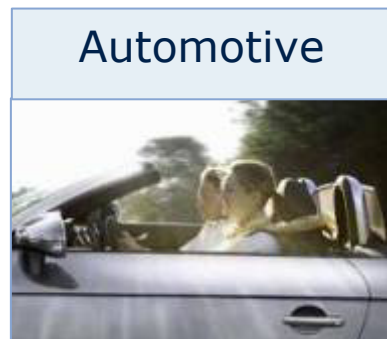
# Ergebnisse nach Segmenten Q4 GJ 2010 Und Q1 GJ 2011

Segmentergebnis* in Mio. Euro				Marge
ATV		Q4 2010	 <b>58</b>	17%
		Q1 2011	 <b>59</b>	17%
IMM		Q4 2010	 <b>106</b>	24%
		Q1 2011	 <b>107</b>	25%
CCS		Q4 2010	 <b>12</b>	10%
		Q1 2011	 <b>10</b>	10%

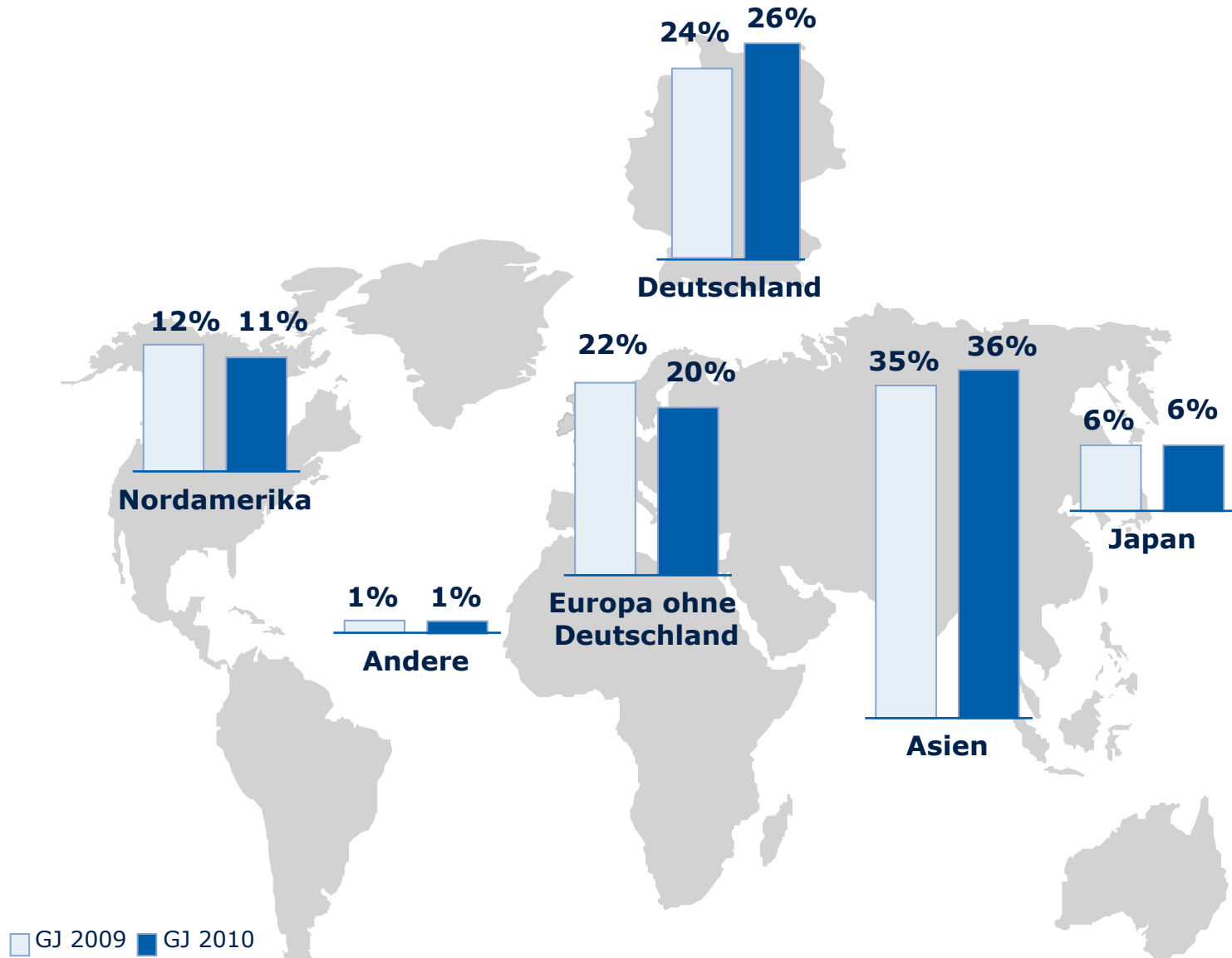
\* Im Gesamtergebnis enthalten sind Sonstige Geschäftsbereiche (Q4 GJ10: 5 Mio. €, Q1 GJ11: 2 Mio. €) sowie Konzernfunktionen und Eliminierungen (Q4 GJ10: -10 Mio. €, Q1 GJ11: -1 Mio. €).

# Umsatz nach Divisionen

## Umsatzverteilung erstes Quartal GJ 2011



# Umsatz nach Regionen GJ 2009 und GJ 2010



■ Markt- und Geschäftsentwicklung im ersten Quartal GJ 2011

■ Zielmärkte

■ Divisionen, Produkte und Technologien

■ Allgemeine Informationen zum Unternehmen

# Infineon Compass - Kurzfassung

## Unsere Bestimmung

Wir sind der Innovationsführer bei Halbleitern für Energieeffizienz, Kommunikation und Sicherheit. Unsere Lösungen unterstützen moderne Gesellschaften zu wachsen und schützen zugleich die Umwelt.

## Unser Weg

Unsere Mitarbeiter sind die Basis der einzigartigen Wettbewerbsvorteile, guter finanzieller Ergebnisse und Höchstleistungen von Infineon. Wir wollen unseren Kunden, Mitarbeitern und Aktionären das Beste bieten – zu jeder Zeit, an jedem Ort.

## Unsere Werte

Vier Grundwerte sind der Antrieb in unserer täglichen Arbeit:

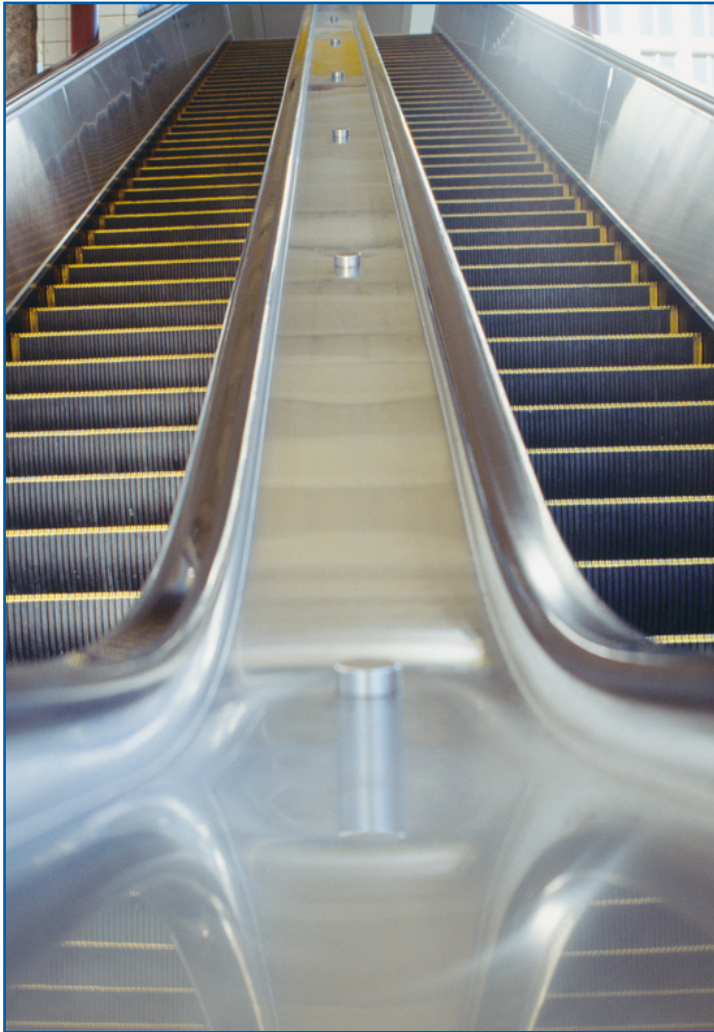
We commit (Wir handeln engagiert und verbindlich) – We innovate (Wir sind innovativ) – We partner (Wir arbeiten partnerschaftlich zusammen) – We perform (Wir bringen Leistung).



Photos: helgahengge.com

# Infineon Compass

# Auf dem Weg zu einem High-Performance-Unternehmen



- Erfolgreiche Umstrukturierung dank IFX10+
  - Konsequente Kostenreduzierung
  - Effizienzsteigerung
- Erfolgreiche Refinanzierung 2009
  - Rückkauf und Tilgung nachrangiger Umtausch- und Wandelanleihen 2009 (Gesamt: 367 Mio. Euro nominal)
  - Ausgabe einer neuen nachrangigen Wandelanleihe mit Fälligkeit 2014, Bruttoertrag ca. 182 Mio. Euro
  - Kapitalerhöhung um 674 Mio. €, zu 100% gezeichnet
  - Striktes Working-Capital-Management, Investitionsdisziplin
- Konsequente Ausrichtung des Infineon-Portfolios an den Zielmärkten
  - Weltweit führend in den Segmenten ATV, IMM und CCS
  - Verkauf von WLC an Golden Gate Capital
  - Verkauf von WLS an Intel
  - Klare Ausrichtung auf drei zentrale Herausforderungen der modernen Gesellschaft:
    - Energieeffizienz
    - Mobilität
    - Sicherheit



# Wir konzentrieren uns auf unsere Zielmärkte

## Fokusthemen

- Energieeffizienz
- Mobilität
- Sicherheit



## Kernkompetenzen

- Analog- und Mixed-Signal-Schaltungen
- Leistungshalbleiter
- Embedded Control
- Fertigungskompetenz

## Unsere Zielmärkte

- Automotive
- Industrial & Multimarket
- Chip Card & Security



# Fokussierung auf drei Bereiche mit hervorragenden Zukunftsperspektiven

## Energieeffizienz



## Mobilität



## Sicherheit



**Automotive**

**Industrial & Multimarket**

**Chip Card & Security**

Maßgebliche Faktoren für die Einführung des neuen Fokusbereichs „Mobilität“:

- Unsere Marktführerschaft im Automotive-Sektor
- Wachsende Bedeutung neuer Mobilitätskonzepte (z.B. Elektromobilität) und
- Innovative Lösungen für den öffentlichen Personenverkehr (Antriebe, elektronische Fahrscheine)

# Energieeffizienz



## Wichtige Trends

- Dem dramatisch steigenden weltweiten Energiebedarf stehen schwindende Ressourcen fossiler Energieträger gegenüber
- Strenge CO<sub>2</sub>-Richtlinien sollen das Erreichen von Klimazielen sichern
- Erneuerbare Energien werden vermehrt als nachhaltige Ressourcen genutzt
- Elektrifizierung des Antriebsstrangs von Kraftfahrzeugen

## Unser Beitrag

- Unsere innovativen Halbleiterlösungen spielen eine wichtige Rolle bei der Minimierung von Leistungsverlusten und steigern die Effizienz der gesamten Energie-Versorgungskette – von der Erzeugung über die Verteilung bis zur Nutzung.
- Unsere Produkte bilden die Grundlage für die intelligente und optimale Nutzung von Energieressourcen in der Industrie, in Privathaushalten und in Fahrzeugen.



## Wichtige Trends

- Strenge CO<sub>2</sub>-Richtlinien und steigender Ölpreis
- Neue Sicherheitsvorschriften für die Unfallprävention
- Wachsender Markt für preiswerte Fahrzeuge in Schwellenländern
- Urbanisierung, Globalisierung und demografische Veränderungen
- Große Investitionen in öffentlichen Nah- und Fernverkehr

## Unser Beitrag

- Unsere führenden Halbleiterlösungen ermöglichen eine nachhaltige Mobilität, indem sie dazu beitragen, Kraftstoffverbrauch und Emissionen zu reduzieren, die Sicherheit zu erhöhen und die Anschaffungskosten zu senken.
- Als Innovationsmotor und Anbieter von Schlüsselkomponenten für Elektro- und Hybridfahrzeuge wird Infineon auch weiter den Wandel in Richtung Elektromobilität mitgestalten.
- Innovative Lösungen für Antriebe und elektronische Tickets im öffentlichen Personenverkehr.



## Wichtige Trends

- Bedarf an sicheren Systemen in allen Bereichen des Lebens
- Sichere Kommunikation überall – mit Mobiltelefon und mobilem Internet
- Einführung von elektronischen Ausweisen und Produktkennzeichen
- Zahlungssysteme mit kontaktlosen Karten und elektronische Tickets
- Zunehmender Einsatz von Elektronik im Auto erfordert sicheres Datenmanagement

## Unser Beitrag

- Maßgeschneiderte Sicherheitslösungen für alle Systemanforderungen ermöglichen die Implementierung transparenter Sicherheitsfunktionen in Standardsystemen.
- Sicherheitsanwendungen in der Industrie und im Automobilsektor profitieren von unserer globalen Kompetenz im Bereich Smartcards.
- Unsere Produkte verbinden Hardware-Sicherheit und Verschlüsselung und bilden damit die Grundlage für Vertraulichkeit und Sicherheit sowie erweiterte Kommunikationsfunktionen, ohne die persönliche Freiheit einzuschränken.

# Wir orientieren uns an unseren Kunden

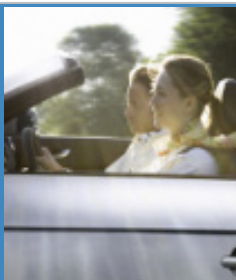


- Markt- und Geschäftsentwicklung im ersten Quartal GJ 2011
- Zielmärkte
- **Divisionen, Produkte und Technologien**
- Allgemeine Informationen zum Unternehmen

## Divisionen

## Kernanwendungen

### Automotive



Antriebsstrang (Motor- und Getriebesteuerung); Hybrid- und Elektroauto; Karosserie- und Komfortelektronik (Lenkung, Dämpfung, Licht, Klimaanlage, Schiebedach, Fensterheber, Scheibenwischer, zentrale Karosseriesteuergeräte, Türelektronik); Sicherheit (ABS, Airbag, ESP)

### Industrial & Multimarket



Steuerung von elektrischen Antrieben für Industrieanwendungen und Haushaltsgeräte; Antriebe für Züge und Bahnen; Module für erneuerbare Energieerzeugung, Energieübertragung und -wandlung; Halbleiterkomponenten für Lichtmanagementsysteme und LED-Beleuchtung; Netzteile für Server, PCs, Notebooks, Netbooks, Spielekonsolen, Unterhaltungselektronik; kundenspezifische Bausteine für Peripheriegeräte für PCs (z.B. Maus), Spielekonsolen, Anwendungen in der Medizintechnik; HF-Bausteine mit Schutzfunktion für Kommunikations- (z.B. GPS, UMTS, WLAN, Digital-TV) und Tunersysteme; Silizium-MEMS-Mikrofone; Leistungstransistoren für Verstärker in Mobilfunk-Basisstationen

### Chip Card & Security



SIM-Karte für Mobiltelefone; Zahlungsverkehr; elektronische Reisepässe, Personalausweise, Gesundheitskarten und Führerscheine; Personenidentifikation; Objektidentifikation; Bezahlfernsehen; Plattformsicherheit bei Rechnern und in Netzwerken; Authentifizierung und Systemintegrität z.B. in Spielekonsolen, Druckern, Industriesteuerungen

Kunden





## Kernkompetenzen/ Value Proposition

- **Nachhaltiges Engagement:** über **40 Jahre System- und Anwendungs-Know-how** im Automotive-Bereich
- **Anbieter kompletter Automotive-Systeme**
- **Hybrid- und Elektrofahrzeuge:** branchenweit **führend bei Know-how** und Produktportfolio
- **Weltweite** Entwicklungs-, Fertigungs- und Support-Standorte für Automotive-Halbleiter
- **Automotive Excellence:** umfangreichstes Qualitätsprogramm in der Halbleiterbranche

## Produktpalette

- **Sensorik:** Druck-, Temperatur-, Magnetsensoren; Wireless Control-ICs, Radar
- **Mikrocontroller:** 8-Bit, 16-Bit, 32-Bit
- **Leistungshalbleiter:** MOSFETs, IGBTs, intelligente Leistungs-ICs: Spannungsregler, Brücken, Treiber-ICs, CAN/LIN/FlexRay™-Transceiver, DC/DC-Wandler, Stromversorgungs-ICs, SoC Embedded Power-ICs
- **Hybrid- und Elektrofahrzeuge:** HybridPACK™-Module, Automotive Easy-Module, Gate-Treiber-ICs, MOSFETs, IGBTs

## Marktposition

- **Nr. 1** bei Automotive-Halbleitern weltweit
- **Nr. 1** in Europa
- **Nr. 2** in der NAFTA-Region
- **Nr. 2** in der übrigen Welt

Quelle: Strategy Analytics (April 2010)

\* FlexRay ist eine Marke der FlexRay Consortium GbR und wird unter Lizenz verwendet

# Fokus auf Zukunftstechnologien

## Beispiel 1: Umweltfreundliche Autos

### Markttrends

- Knapper werdende Energieressourcen
- Strengere Vorgaben zum CO<sub>2</sub>-Ausstoß
- Wachsendes Umweltbewusstsein

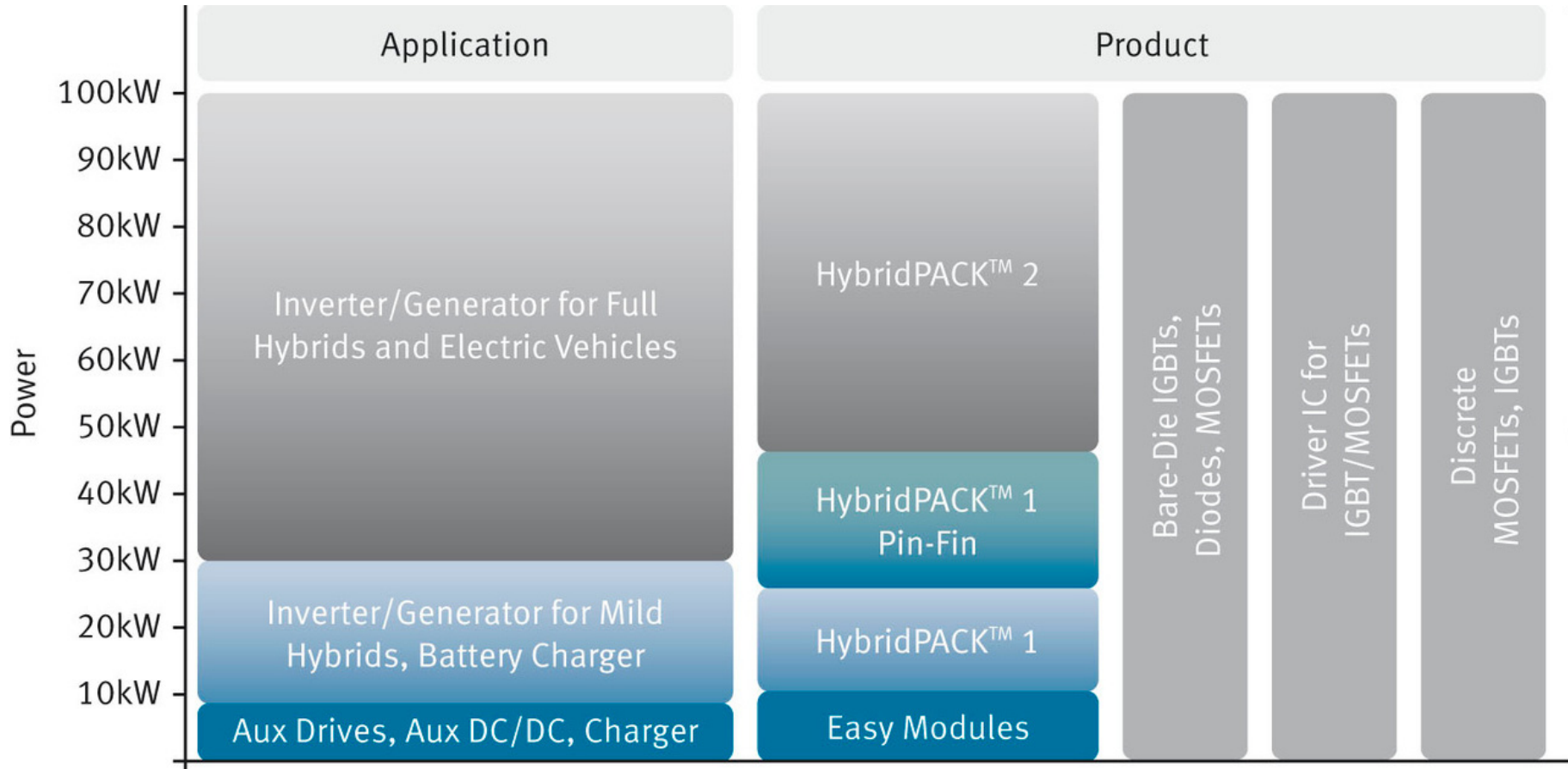
### Chancen für Infineon

- Infineon-Bausteine ermöglichen eine erhebliche CO<sub>2</sub>-Reduzierung um insgesamt ~23 g/km
- Wir bieten Produkte für den Antriebsstrang von Hybrid- und Elektrofahrzeugen (HybridPACK™)
- Halbleiter machen Elektroautos überhaupt erst möglich (elektrische Antriebe/ Steuerungen, Batteriemanagement, integrierte Batterieladefunktionen und Fahrzeugnetzkommunikation)

Hinweis: CO<sub>2</sub>-Reduzierung bei EU-Durchschnittsautos: 170 g/km



# Zielanwendungen für die Elektrifizierung des Antriebsstrangs – Produktportfolio





## Kernkompetenzen/ Value Proposition

- Hochwertige Produkte und Services
- Führendes Technologie- und IP-Portfolio
- System-Know-how und umfassendes Anwendungswissen
- Starke weltweite Präsenz mit Standorten für lokale Vertriebs- und Anwendungsunterstützung
- Dedizierte Kundenbetreuungsteams und Distributoren

## Produktpalette

- Diskrete Leistungshalbleiter, Leistungsmodule und Power Stacks
- Stromversorgungs-ICs
- NF/HF-Dioden und -Transistoren, HF-Leistungsverstärker
- Silizium-MEMS-Mikrofone, TVS-Dioden
- LED-Treiber
- ASIC-Lösungen einschließlich Sicherheits-ASICs für Authentifizierungs- und Markenschutzanwendungen
- Mikrocontroller: 8-Bit, 16-Bit, 32-Bit

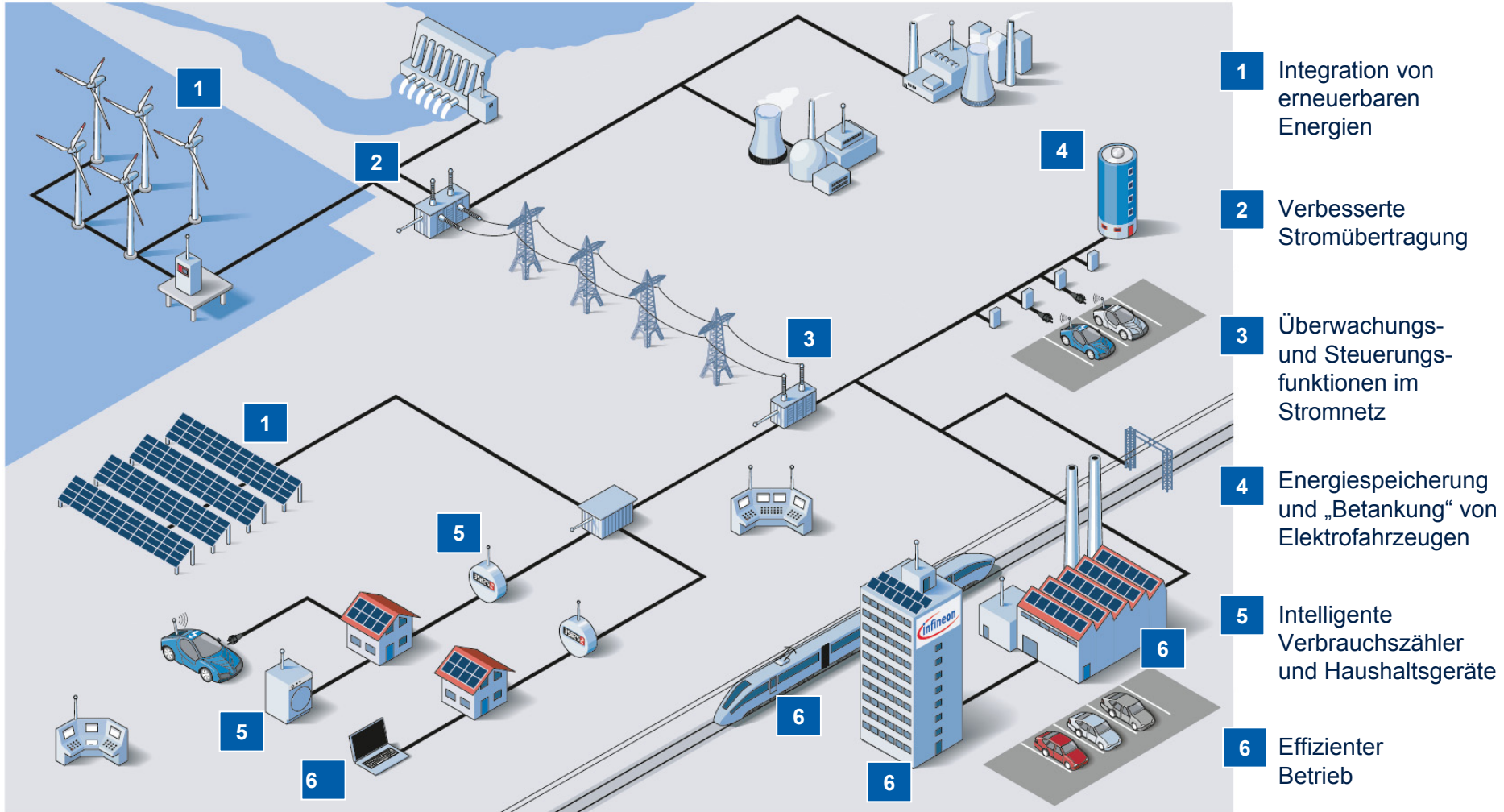
## Marktposition

- Nr.1 bei Leistungshalbleitern sieben Jahre in Folge
  - Nr.2 bei Leistungsmodulen mit 20,5% Marktanteil
  - Nr.1 bei diskreten Leistungshalbleitern mit 8,2% Marktanteil

Quelle: IMS Research, Juli 2010

# Fokus auf Zukunftstechnologien

## Beispiel 2: Smart Grid



# Leistungskomponenten für die Antriebssteuerung bei Zugsystemen

## Hochgeschwindigkeitszüge



## U-Bahn



## Infineon-Komponenten

- Leistung: 5 bis 10MW pro Zug
- 80 bis 120 IGBT-Module pro Zug
- Halbleiteranteil:  
~100.000 EUR pro Zug



- Leistung: 0,5 bis 1MW pro Zug
- 25 bis 50 IGBT-Module pro Zug
- Halbleiteranteil:  
~10.000 EUR pro Zug



## Produktpalette

- Kontaktlose und kontaktbasierte Sicherheitsprodukte für Kommunikation, Zahlungsverkehr, amtliche Ausweise, Personen- und Objektidentifikation, Unterhaltung und Plattformensicherheit
- Umfassendes Packaging- und Serviceangebot
- Innovative Lösungen von einfachen Sicherheits-RFID- und Speicheranwendungen bis hin zu High-End-Sicherheitscontrollern (z.B. die preisgekrönte SLE 78-Familie)

## Kernkompetenzen/ Value Proposition

- Tailored Security: maßgeschneiderte Sicherheit mit ausgezeichnetem Preis-Leistungs-Verhältnis
- Contactless Excellence: Schwerpunkt auf Interoperabilität und Dual Interface
- Embedded Control: ausgewogenes Verhältnis von Rechenleistung, Stromverbrauch, Sicherheitsniveau und Kosten

## Marktposition

- Nr. 1 auf dem Chipkarten-IC-Markt seit 13 Jahren mit Marktanteil von 27%<sup>1</sup> nach Umsatz
- Marktführer bei behördlichen Ausweisen und Zahlungsanwendungen
- Etwa 50 Prozent aller 2009 ausgestellten behördlichen Ausweise verwenden Sicherheitschips von Infineon (ohne Berücksichtigung von China)
- Infineon liefert die Chips für das europaweit größte Ausweisprojekt, den neuen deutschen elektronischen Personalausweis (nPA)

# Konzentration auf Zukunftstechnologien

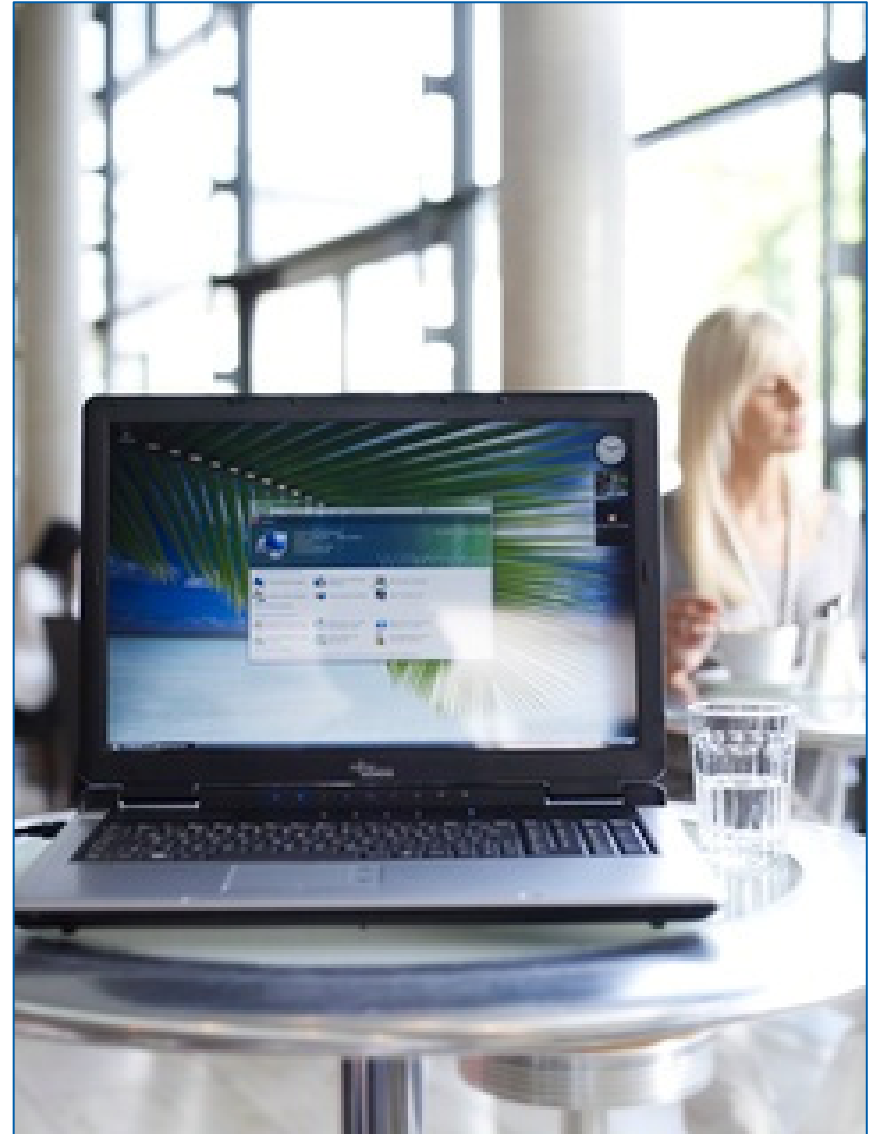
## Beispiel 3: Datenschutz

### Markttrends

- TPM (Trusted Platform Module)-Chips in 70% aller Firmen-Notebooks und -PCs; Windows 7-Unterstützung
- Datenschutz: Verschlüsselung von Dateien, Ordnern, Festplatten, Nachrichten und digitalen Signaturen
- Starke Authentifizierung: Netzwerkzugangsschutz und zusätzlicher Authentifizierungsfaktor

### Chancen für Infineon

- Marktführer bei TPM-Lösungen
- TPM-Sicherheitschips von Infineon erhielten als erste die weltweite TCG- und Common Criteria-Zertifizierung und sind von der britischen Regierung für sicherheitskritische Anwendungen zugelassen







## Die wichtigsten Kunden

### Automotive

- Autoliv
- Bosch
- Continental
- Delphi
- Denso
- Hella
- Hyundai
- Kostal
- Lear
- Mitsubishi
- TRW
- Valeo

### Industrial & Multimarket

- ABB
- Alstom
- Cisco
- Convertteam
- Dell
- Delta
- Emerson
- Ericsson
- HP
- LG Electronics
- Microsoft
- Nokia
- Panasonic
- Philips
- RIM
- Samsung
- Schneider Electric
- Siemens
- SMA Technology
- Sony

### Chip Card & Security

- Beijing Watch Data
- Cisco
- Gemalto
- Giesecke & Devrient
- Oberthur
- Sagem Orga
- US Government Printing Office

- **Wichtigste Channel-Partner** (Distributoren):  
Arrow, Avnet, Beijing Jingchuan, Rutronik, Tomen, Toyotsu, WPG Holding
- **Electronic Manufacturing Services (EMS):**  
Celestica, Flextronics, Foxlink, Hon Hai, Jabil, Sanmina-SCI

# Das Halbleitertechnologie-Portfolio von Infineon



## Technologieportfolio für die Anforderungen von Logik- und Leistungsanwendungen

**Power/Analog**

**inkl. Green Robust**

<b>Analog Bipolar:</b>	DOPL, Ax, BIPEP, B4C	<b>DMOS:</b>	KSPx, PFET (P-Kanal)
<b>Analog BICMOS:</b>	B6CA, B6CA-CT, B7CA, SPT170	(OptiMOS)	KSNx, EH4, SFETx (N-K.)
	500 - 350nm HV-CMOS-SOI	<b>HV-DMOS:</b>	EH5/6, EHATx,
<b>Smart Power:</b>	1200-130nm BIP/CMOS/DMOS	(CoolMOS)	EHATDx, EHCx, EHCxD
	SPTx (Automotive, EDP) (BCD)	<b>IGBT:</b>	IGBTx, LightMOS, ZIGBT
<b>Smart:</b>	CMOS/DMOS, SMARTx,	<b>Fast Recov.-Dioden:</b>	FRSTD (ECxxx)
(SmartMOS)	MSMARTx, SSMARtx Opto-TRIAC	<b>SiC-Bausteine:</b>	Dioden; MOS/JFET
<b>alle Produkte für Automotive- und Industrieanwendungen geeignet</b>			

**MEMS/Sensoren**

<b>Analog-ICs:</b>	B6CA, B7CA	<b>Druck:</b>	BxCSP, TIREPx
	Coreless Transformer	<b>Mikrofon:</b>	DSOUND
<b>Magnet:</b>	BxCAS, C9FLRN_GMR		
<b>Opto:</b>	OP-DI, OP-TR, OP-C9N, Mikromodule		

**CMOS**

<b>Digital-CMOS:</b>	800nm – 65nm-Technologieknoten (Plattform <180nm inkl. HF, AMS)		
<b>Analog/Mixed Signal:</b>	500nm – 180nm- Technologieknoten (CxNA)		
<b>eNVM:</b>	EEPROM: IMEMR, C9FL		
	OTP: C5OP (Automotive)		
<b>eFlash/EEPROM:</b>	250nm – 65nm CxFL (Chipkarten), CxFLA, CxFLN (Automotive)		

**HF/Bipolar**

<b>HF-BICMOS:</b>	25GHz – 100GHz: B6HFC, B9COPT, B10C		
<b>Bipolar-IC:</b>	NF-IC,		
	2GHz...200GHz HF-Bipolar: BxHF		
<b>HiPAC:</b>	Al/Cu Integrated Passives	<b>SiGe:</b>	B7HFM, B7HF_SLC, B7HF200
	P7Mxx, P7Dxx, P8Mxx, P9Mxx	<b>HF-Schalter:</b>	C7NP, C11NP
<b>Bipolar/Diskrete Bausteine/MMIC:</b>		<b>SiGe:</b>	B7HFD/M, B7HF_SD
<b>RF-Transistoren:</b>	NF-TR; BxHF(D/M),	<b>RFMOS:</b>	HFM
<b>Leistungsverst.:</b>	LDMOS, LDxM, LDxIC, LD9AB	<b>PIN:</b>	DxP
<b>Dioden:</b>	NF-DI, Tuner: DxT, Schottky: DxS		

# Das Gehäusetechnologie-Portfolio von Infineon



## ICs

## Leistungshalbleiter

Wafer Level Package, Bare Die

Laminat-gehäuse

Leadframe-basierte Gehäuse

Chipkarten

Diskrete Bausteine

Sensoren

High Power

Leistungs-  
halbleiter

**Surface Mount-Technologie (SMD)**

**Wafer Level**  
ohne Umverteilung  
▪ WLP (Fan-In)  
mit Umverteilung  
▪ WLB (Fan-In)  
▪ eWLB (Fan-Out)  
**Bare Die**  
▪ Drahtanschl.  
▪ Flip-Chip

**SMD**  
▪ OCCN <sup>1)</sup>  
▪ BGA  
▪ LBGA  
▪ xFBGA,  
xFSGA

**Flip-Chip**  
▪ FCxBGA  
▪ xF2BGA,  
xF2SGA

**Through Hole**  
▪ DIP <sup>2)</sup>  
**SMD**  
▪ PLCC <sup>2)</sup>  
▪ TSSOP  
▪ TQFP  
▪ LQFP  
▪ MQFP  
**Leadless**  
▪ VQFN  
▪ O-LQFN <sup>1)</sup>

**Mold on LF**  
▪ P-MCCx  
**Mold**  
▪ P-Mx.x  
**Chip on Flex**  
▪ FTM  
**UV Globe Top**  
▪ T-Mx.x  
**PRELAM**  
▪ PPxx

**Flip-Chip**  
▪ S-MFCx.x

**Wafer**  
▪ Bumped  
▪ Diced

**SMD Ledged**  
▪ SOT  
▪ SOD  
**Flat Lead**  
▪ TSFP  
▪ SC

**Leadless**  
▪ TSLP  
▪ TSSLP  
▪ TSNP

**Wafer Level**  
▪ WLP

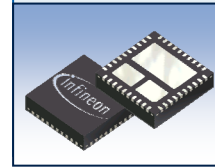
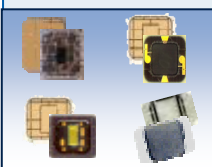
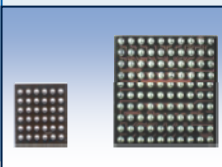
**Through Hole**  
▪ PSSO  
**SMD Ledged**  
▪ DSO  
▪ SC  
▪ TSOP

**Open Cavity**  
▪ DSOF

**Leistungs-  
module**  
▪ Easy  
▪ 62mm  
▪ Econo  
▪ Econo  
PACK+  
▪ PrimePACK  
▪ IHM  
▪ IHV  
▪ Hybrid  
PACK

**Through Hole**  
▪ TO, DIP  
**SMD**  
▪ TO  
▪ DSO  
▪ SSOP  
**Leadless**  
▪ TDSON  
▪ TSDSON  
▪ CanPAK  
▪ SON  
▪ QFN

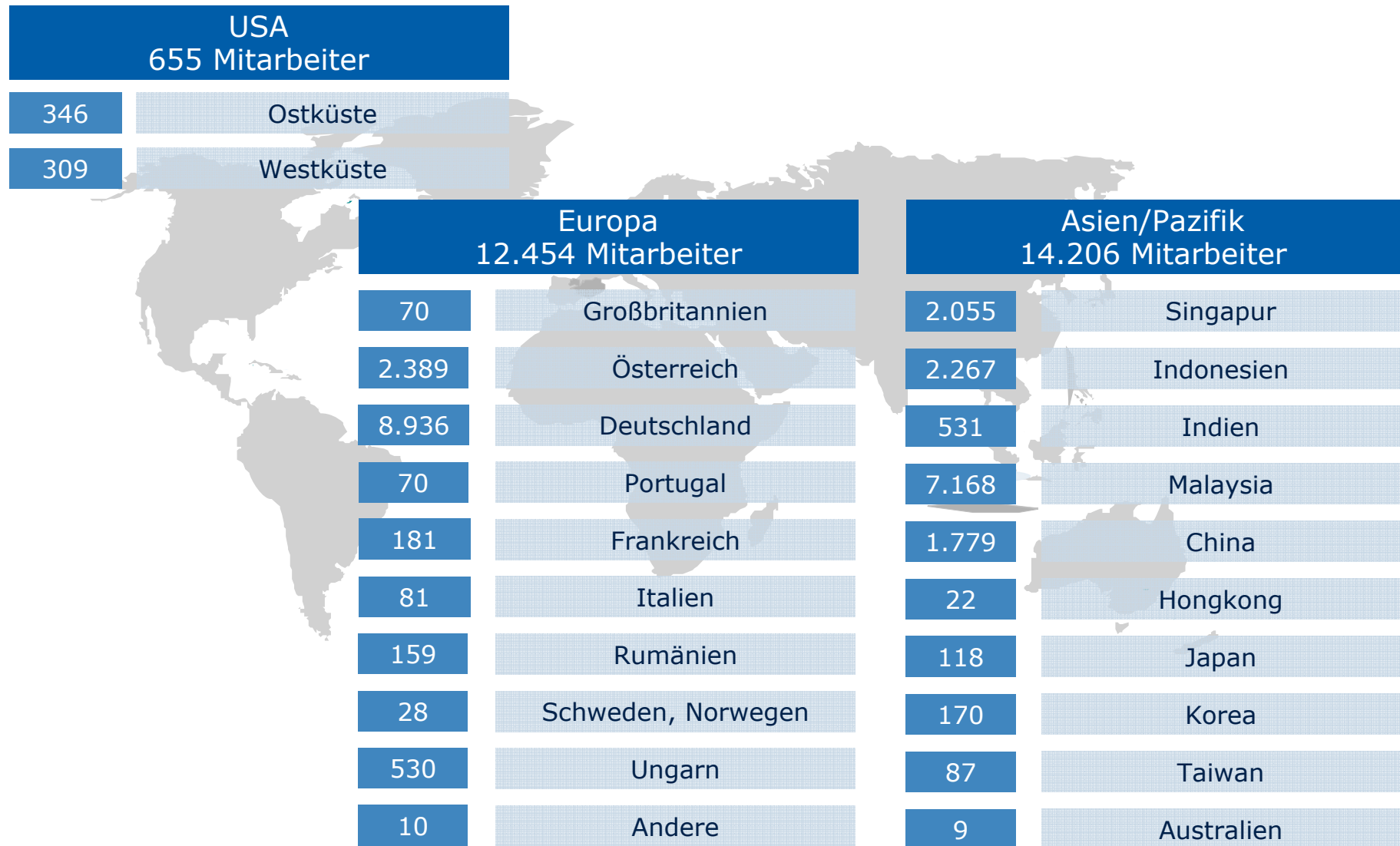
**SIP Low  
Power**  
▪ IDC  
**SIP Medi.  
Power**  
▪ CIPOS



1) Nur für Spezialanwendungen 2) Auslauf

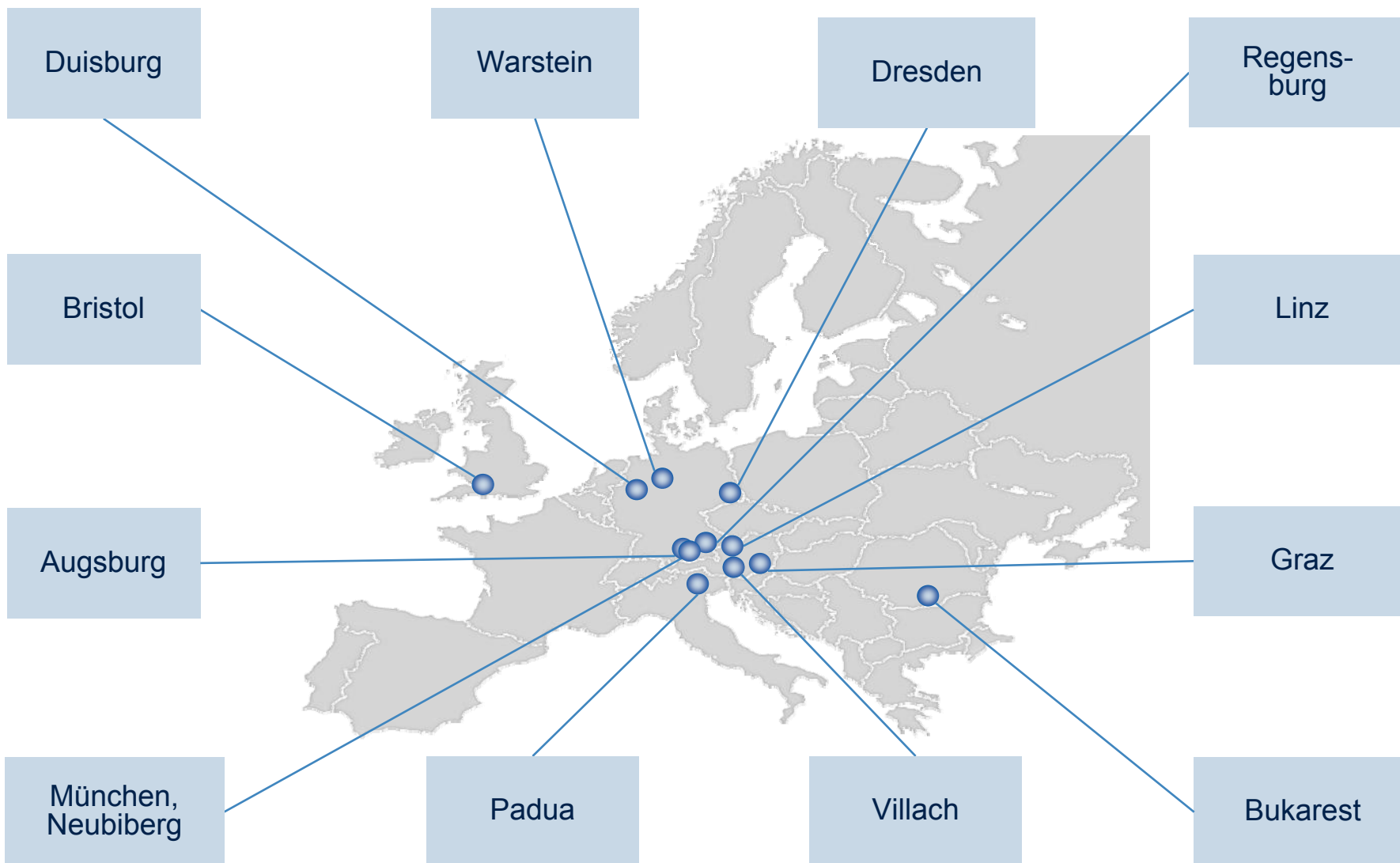
- Markt- und Geschäftsentwicklung im ersten Quartal GJ 2011
- Zielmärkte
- Divisionen, Produkte und Technologien
- **Allgemeine Informationen zum Unternehmen**

# Infineon: 27.315 Mitarbeiter weltweit



\*Hinweis: Beinhaltet die Wireless-Sparte als nicht fortgeführte Aktivität; Stand: 31. Dezember 2010

# Infineon – F&E-Standorte in Europa



# Infineon – Weltweite F&E-Standorte (ohne Europa)



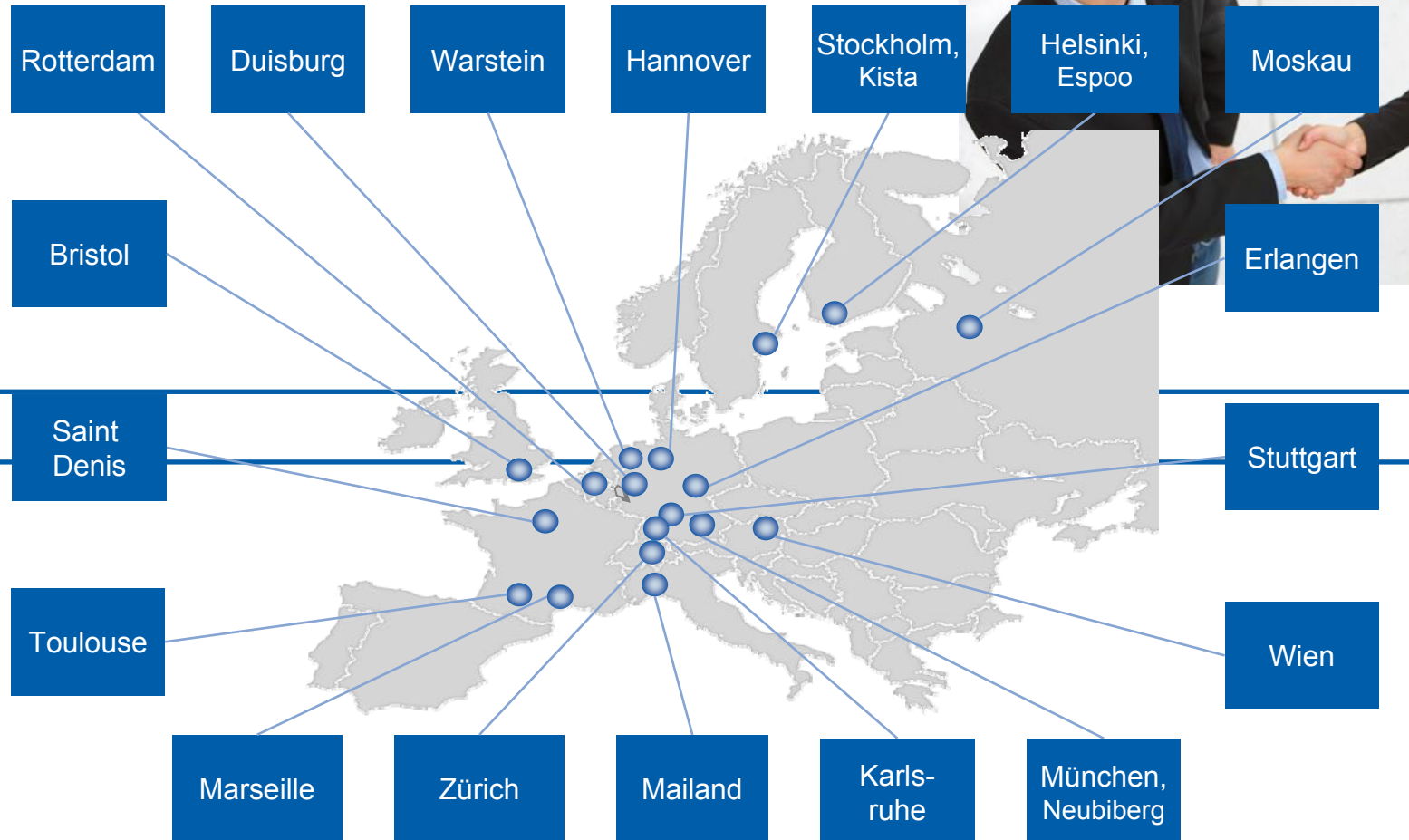


# Infineon – Weltweite Fertigungsstätten Front-End- und Back-End-Fertigung



■ Front-End ■ Back-End

# Infineon-Vertriebsbüros in Europa



# Infineon-Vertriebsbüros weltweit (ohne Europa)



# Nachhaltigkeit für Mensch und Umwelt



**Umfassendes und modernes Nachhaltigkeitskonzept bei Infineon**

# Nachhaltigkeit für Mensch und Umwelt

## IMPRES\*): Synergie aus Verantwortung für Mensch und Umwelt und wirtschaftlichem Erfolg

### Mehrere Standorte nach EN ISO 14001 und OHSAS 18001 zertifiziert



**Effiziente Ressourcennutzung** schützt **Umwelt und Gesundheit** und gewährleistet **hohe Sicherheitsstandards**

**Freiwillige Selbstverpflichtung** zur Senkung der Treibhausgasemissionen

**Intelligente Konzepte** zur Verringerung von Abfällen und Emissionen

Die Herstellung von Produkten und das Supply Chain Management gehen mit **verantwortungsvollem Handeln** einher

## Nachhaltiges und verantwortungsvolles Handeln bedeutet für Infineon weit mehr als nur die gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen

\*)) Infineon Integrated Management Program for Environment, Safety and Health

# Nachhaltigkeit für Mensch und Umwelt

## Infineon hat weltweit eines der fortschrittlichsten Nachhaltigkeitskonzepte

### Arbeitssicherheit

- Im Vergleich zu den Zahlen der deutschen Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse ist die Unfallrate bei Infineon auf einem vorbildlich niedrigen Niveau – wobei unsere Erfassungsmethode sogar noch strenger ist.

### Unsere Produkte

- ... ermöglichen energieeffiziente Endprodukte und Anwendungen.
- ... werden einer besonderen Lebenszyklusanalyse unterzogen, um den ökologischen Fußabdruck möglichst gering zu halten.
- ... fördern die Entwicklung umweltfreundlicher Anwendungen.

### Unsere Fertigungsprozesse

- ... ermöglichen Energieeinsparungen in der Größenordnung des Jahresverbrauchs einer Stadt mit 1,5 Mio. Einwohnern bzw. der Stromleistung eines Kohlekraftwerks über 1,3 Jahre hinweg.
- ... haben uns geholfen, die Vorgaben unserer freiwilligen Selbstverpflichtung zur Reduzierung von PFC-Emissionen drei Jahre früher zu erreichen als weltweit von der Branche anvisiert.
- ... gelten als Maßstab in puncto Ressourcenschonung.





# ENERGY EFFICIENCY MOBILITY SECURITY

Innovative semiconductor solutions for energy efficiency, mobility and security.

